

# 半导体涨价攻入终端，华为重磅发布 新一代算力加速卡

## 半导体行业周报

投资评级：推荐（维持）

报告日期：2026年03月23日

- 分析师：何鹏程
- SAC编号：S1050525070002

研究创造价值

## 半导体涨价攻入终端：手机率先调价，家电汽车亦承压

上周，手机品牌OPPO刚宣布调价；本周，vivo紧随其后，宣布从2026年3月18日10时起，调整部分产品的建议零售价。二者涨价原因均指向全球半导体及存储成本上升。本轮涨价潮始于AI需求带动的存储芯片价格飙涨，进而影响整条产业链。如今，价格已经传导至终端，各大厂商陆续上调价格或下调产品配置。从行业影响来看，消费电子销量阶段性承压难以避免，行业资源与定价能力或进一步向具备规模与供应链优势的头部品牌集中。同时，随着半导体产品普遍提价，不仅是手机、电脑，家电、汽车等大量使用半导体的产品或也面临提价压力。

## 华为重磅发布新一代算力加速卡

在本次华为中国合作伙伴大会上，昇腾950PR随标卡Atlas 350如约亮相，受到业界的广泛关注。与前一代昇腾芯片相比，昇腾950PR在低精度数据格式、向量算力、互联带宽及自研HBM等方面实现大幅提升。据华为昇腾计算业务总裁张迪焯介绍，Atlas 350的单卡算力达到了英伟达H20的2.87倍，是目前国内唯一支持FP4低精度的推理产品；HBM容量是H20的1.16倍，达到了112GB，多模态生成速度可以提升60%。昇腾联合20家行业头部伙伴，发布了2026昇腾AI应用场景解决方案，覆盖辅助办公、AI实训、电子病历、智能客服、政务办公等多个行业核心场景。此外，“养虾”热潮再度激起了一体机的需求，过去一个多月已有十几家合作伙伴推出了基于昇腾的 OpenClaw 一体机。目前，昇腾已联合伙伴打造400多款行业一体机，服务客户2700家，占据国内一体机市场80%以上份额。

建议关注：航天电器、天数智芯、芯原股份

中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

产先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

# 重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2026-03-22 股价	EPS			PE			投资评级
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E	
9903.HK	天数智芯	293.40	-5.45	-3.98	-1.78	-53.83	-73.72	-164.83	买入
002025.SZ	航天电器	63.44	0.76	0.77	1.10	83.47	82.39	57.67	买入
688521.SH	芯原股份	199.50	-1.20	-1.00	0.33	-166.25	-199.50	605.83	未评级

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期）

# 目录

CONTENTS

1. 半导体板块周度行情分析
2. 行业高频数据
3. 行业动态
4. 公司公告

# 01 半导体板块周度行情分析

研究创造价值

# 1.1、周涨幅排行

3月16日-3月20日当周，海外龙头总体呈上涨态势。其中，稳懋领涨，涨幅为9.90%。

图表2：海外半导体龙头估值水平及周涨幅（%）

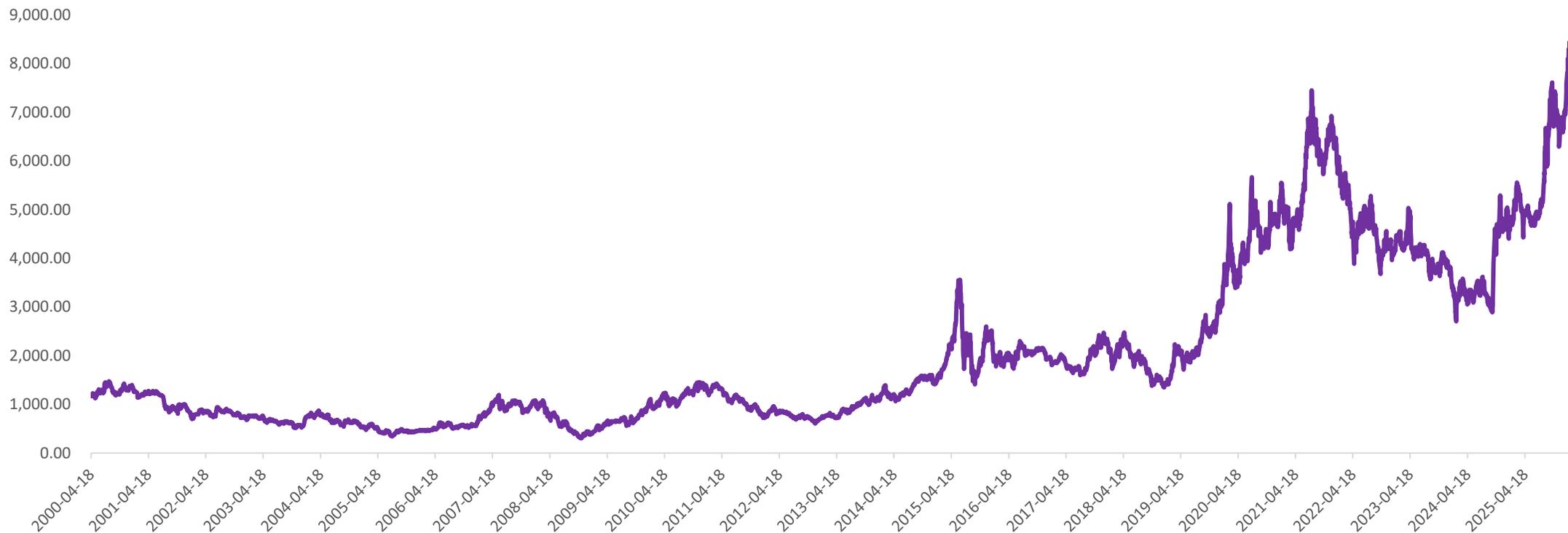
	证券代码	证券简称	国家/地区	市值（亿元）	PE (LYR)	PB (MRQ)	周涨跌幅（%）
处理器	INTC. 0	英特尔 (INTEL)	美国	2191.31	-820.71	1.92	-4.15
	QCOM. 0	高通 (QUALCOMM)	美国	1386.03	25.01	6.01	0.06
	AMD. 0	超威半导体 (AMD)	美国	3282.51	75.72	5.21	4.11
	NVDA. 0	英伟达 (NVIDIA)	美国	41966.10	34.95	26.68	-4.19
存储	MU. 0	美光科技 (MICRON TECHNOLOGY)	美国	4769.19	55.85	6.58	-0.76
模拟	TXN. 0	德州仪器 (TEXAS INSTRUMENTS)	美国	1704.30	34.27	10.47	-1.88
	ADI. 0	亚德诺 (ANALOG)	美国	1510.65	66.63	4.47	1.10
	AVGO. 0	博通 (BROADCOM)	美国	14701.62	63.57	18.41	-3.62
	NXPI. 0	恩智浦半导体 (NXP SEMICONDUCTORS)	荷兰	483.58	23.93	4.81	0.27
射频	SWKS. 0	思佳讯 (SKYWORKS)	美国	81.86	17.16	1.42	-0.55
	QRVO. 0	QORVO	美国	72.42	130.21	1.96	0.05
功率半导体	STM. N	意法半导体	荷兰	274.27	165.23	1.54	-6.11
	ON. 0	安森美半导体 (ON SEMICONDUCTOR)	美国	233.50	192.97	3.04	1.21
	IFX. DF	英飞凌科技	德国	489.07	48.18	2.80	-5.50
光学	3008. TW	大立光	中国台湾	3143.18	14.77	1.66	0.43
	半导体设备	AMAT. 0	应用材料 (APPLIED MATERIAL)	美国	2833.66	40.49	13.05
LRCX. 0		拉姆研究 (LAM RESEARCH)	美国	2851.69	53.22	28.11	7.62
KLAC. 0		科天半导体 (KLA)	美国	1964.41	48.36	35.94	5.64
ASML. 0		阿斯麦	荷兰	5187.73	46.08	22.58	-2.11
6488. TWO		环球晶圆	中国台湾	2242.35	30.67	2.40	8.44
晶圆代工	2330. TW	台积电	中国台湾	543927.45	27.78	8.80	-1.34
	GFS. 0	格芯 (GLOBALFOUNDRIES)	开曼群岛	236.54	26.73	1.98	2.91
化合物半导体	3105. TWO	稳懋	中国台湾	1458.35	86.10	3.51	9.90
封装	ASX. N	日月光投资	中国台湾	470.58	36.46	4.27	-0.88
分销	ARW. N	艾睿电子 (ARROW ELECTRONICS)	美国	69.80	12.22	1.06	-2.71
	AVT. 0	安富利 (AVNET)	美国	47.85	19.92	0.97	-2.14

资料来源：wind，华鑫证券研究

## 1.2、申万一级行业估值水平

3月16日-3月20日当周，申万半导体指数整体呈现震荡下行的态势。3月20日，申万半导体指数为7,309.41，周跌幅为-1.78%。

图表3：近5年申万半导体指数

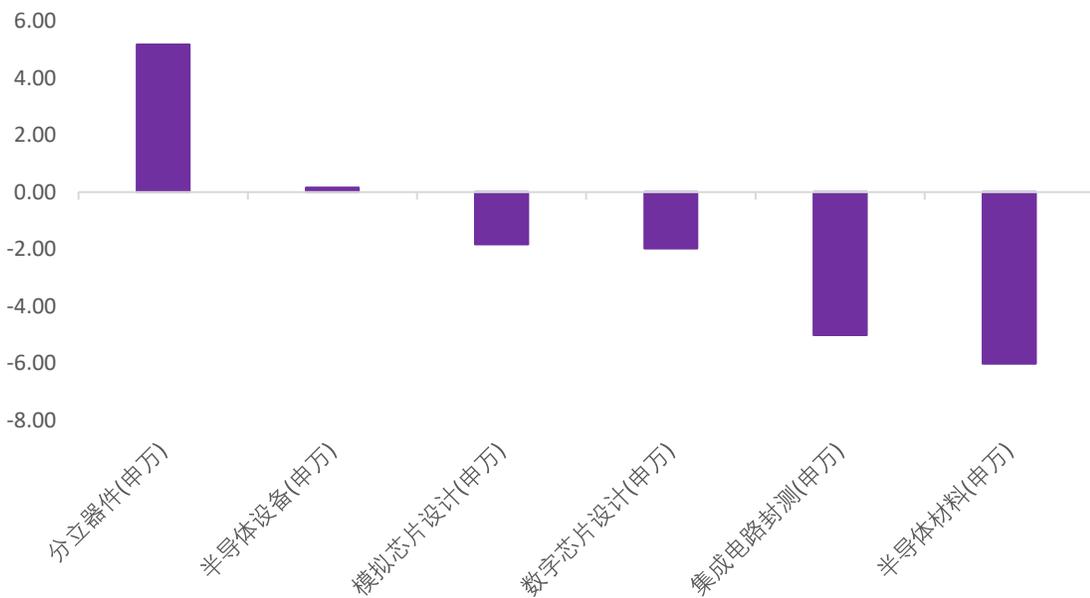


资料来源：wind，华鑫证券研究 注：按申万行业二级分类

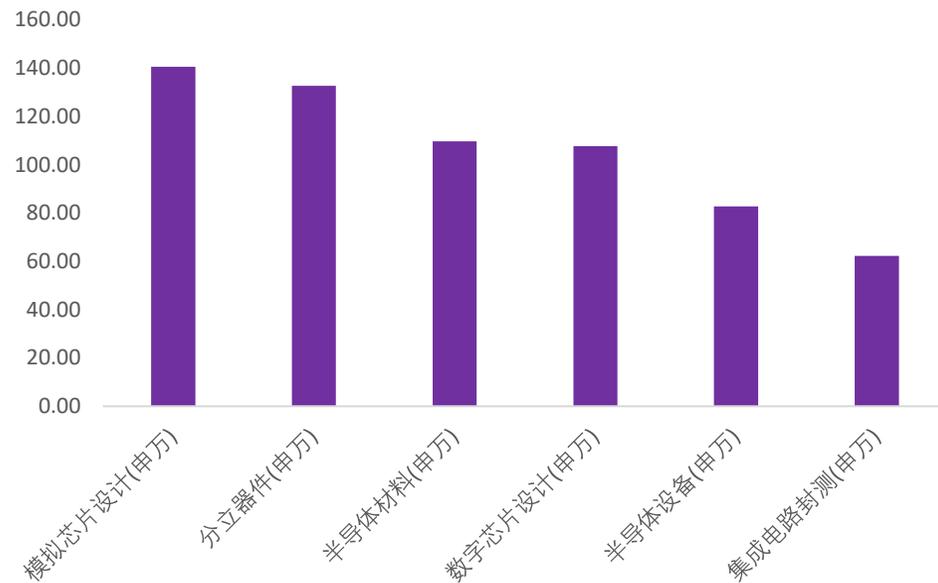
# 1.3、半导体细分板块周度行情梳理

半导体细分板块比较，3月16日-3月20日当周，半导体细分板块呈下跌态势。其中，半导体材料板块跌幅最大，达到-6.01%；分立器件板块上涨最大，达到5.17%。估值方面，模拟芯片设计，分立器件，半导体材料板块估值水平位列前三。

图表4：3月16日-3月20日半导体主要指数周涨跌幅比较（%）



图表5：3月20日半导体主要指数市盈率（TTM）比较



资料来源：wind，华鑫证券研究

## 1.4、申万二级行业板块资金流向

上周申万行业资金流向情况：

通信设备块主力净流入27.24亿元，主力净流入率为0.42%，在9个二级子行业中排第1名；军工电子板块主力净流出57.08亿元，主力净流入率为-3.75%，在9个子行业中排第9名。

图表6：3月16日-3月20日申万行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW通信设备	30,917,174.34	30,644,728.66	272,445.67	0.42	1
SW其他电子II	3,987,136.15	3,991,626.14	-4,489.99	-0.04	-2
SW半导体	33,726,422.87	34,011,008.34	-284,585.47	-0.34	-2
SW消费电子	9,664,719.66	10,191,922.83	-527,203.17	-1.99	-4
SW电子化学品II	2,761,343.99	2,995,053.88	-233,709.89	-2.60	-5
SW航天装备II	1,330,973.28	1,476,661.86	-145,688.58	-2.89	-5
SW其他电源设备II	3,403,805.91	3,748,154.44	-344,348.53	-3.18	-2
SW计算机设备	4,199,404.09	4,664,661.30	-465,257.20	-3.34	-2
SW军工电子II	4,860,505.04	5,431,267.07	-570,762.03	-3.75	-2

资料来源：wind，华鑫证券研究

## 1.5、半导体板块公司周涨幅前十股票

3月16日-3月20日当周，半导体板块公司周涨幅前十个股：源杰科技，国科微，长光华芯，普冉股份，佰维存储，燕东微，卓胜微，赛微微电，华峰测控，大港股份，周涨幅分别为：26.80%，21.34%，17.39%，14.76%，13.92%，13.78%，13.46%，10.07%，7.51%，5.69%。

图表7：半导体板块公司周涨幅前十股票

证券代码	证券简称	市值 (亿元)	EPS			PE			PB	周涨跌幅 (%)
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E		
688498.SH	源杰科技	958.31	-0.07	1.34	2.02	-15623.21	833.31	550.75	41.09	26.80
300672.SZ	国科微	423.57	0.45	-0.88	2.24	440.56	-	-	10.41	21.34
688048.SH	长光华芯	358.10	-0.57	-	0.44	-364.57	-	461.72	11.92	17.39
688766.SH	普冉股份	414.55	2.77	3.39	3.96	141.77	115.80	99.18	17.14	14.76
688525.SH	佰维存储	1115.88	0.37	1.92	4.16	825.09	124.68	57.40	20.51	13.92
688172.SH	燕东微	658.85	-0.15	-	-0.85	-300.74	-	-54.00	3.59	13.78
300782.SZ	卓胜微	483.05	0.75	3.45	0.67	119.97	26.24	135.12	4.88	13.46
688325.SH	赛微微电	115.86	0.93	-	-	146.95	-	-	6.59	10.07
688200.SH	华峰测控	365.94	2.47	-	4.97	109.59	-	54.33	8.97	7.51
002077.SZ	大港股份	97.03	0.04	-	-	369.12	-	-	2.89	5.69

资料来源：wind，华鑫证券研究

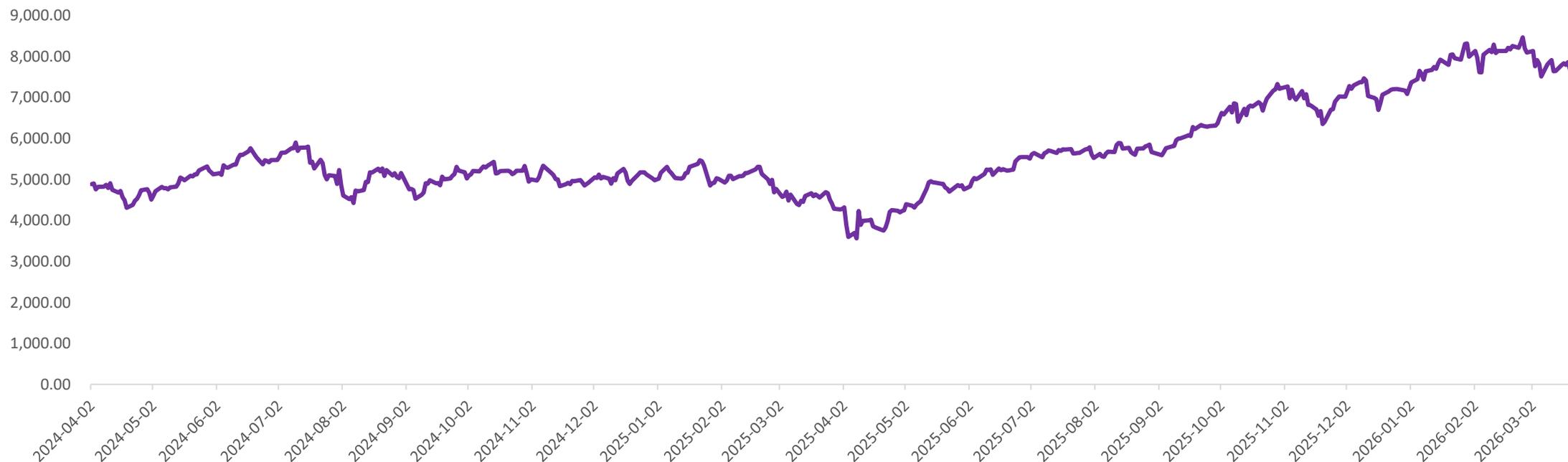
# 02 行业高频数据

研究创造价值

## 2.1、半导体：费城半导体指数

海外方面，3月16日-3月20日当周，费城半导体指数总体呈现震荡的态势，在2026年3月20日出现下跌，近两周整体呈现震荡的态势。更长时间维度上来看，2023年年底开始持续上涨。2024年上半年整体处于上升态势，7月出现大幅回调，8月处于震荡下行行情，9月出现探底回升，四季度总体处于震荡的态势。2025年一季度呈现先涨后跌的走势，4月后逐渐回升，二季度三季度均呈现震荡上行的态势。

图表8：费城半导体指数近两年走势

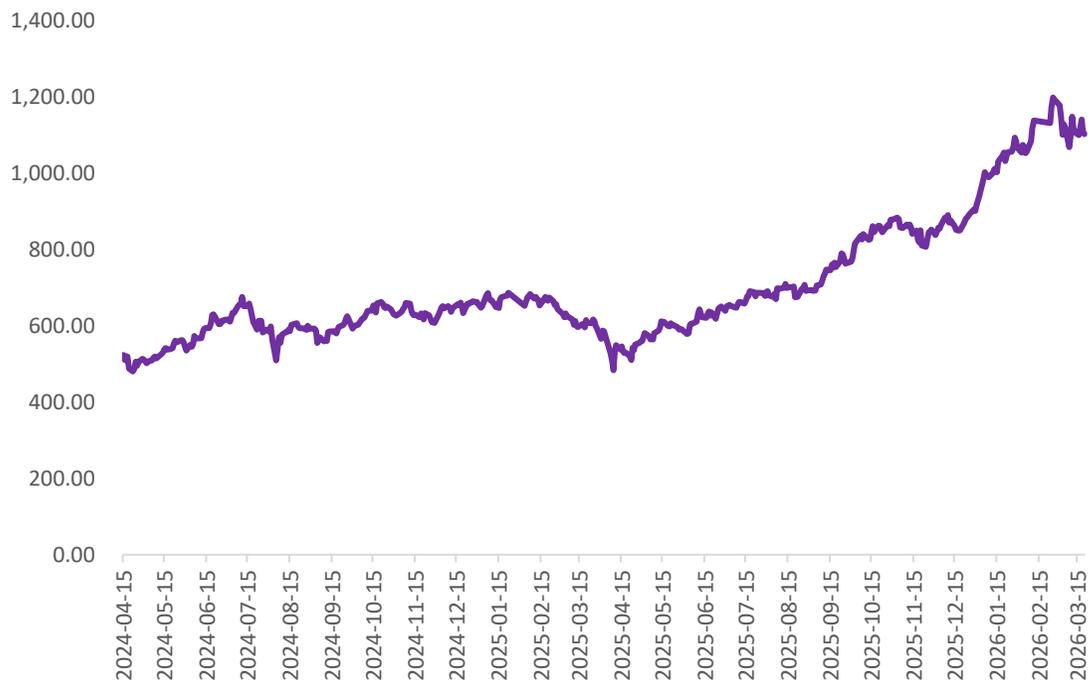


资料来源：wind，华鑫证券研究

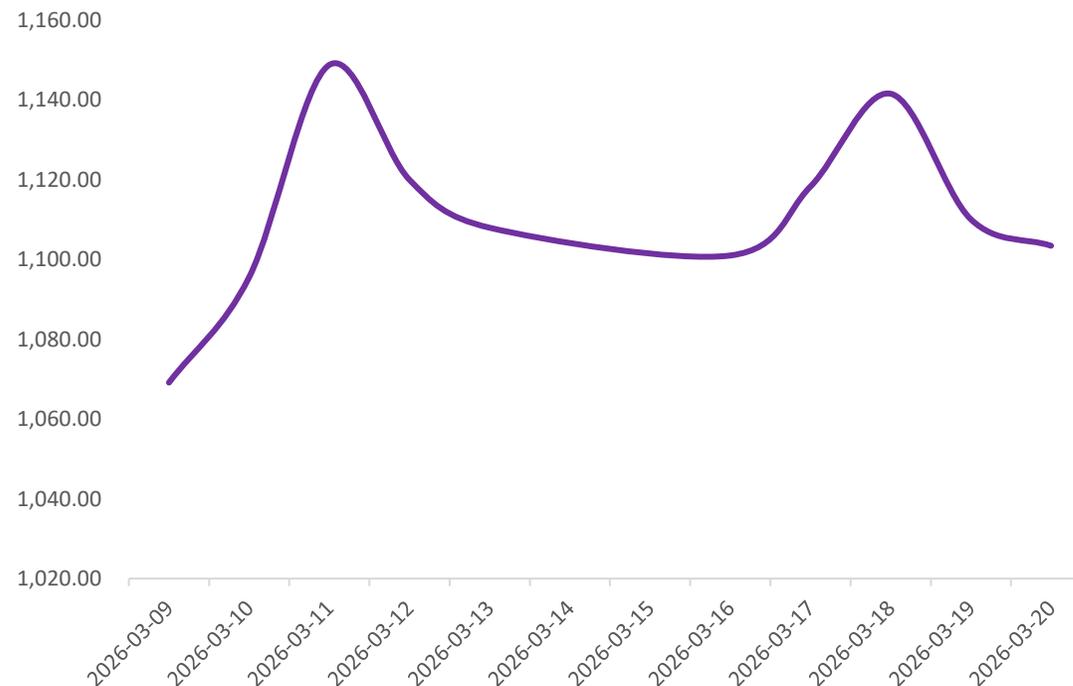
## 2.2、半导体：台湾半导体行业

此外，我们选取台湾半导体行业指数来观察行业整体景气。近两周来看，3月9日-3月20日两周，台湾半导体行业指数呈现整体动荡的态势。近两年来看，2024年二季度台湾半导体指数呈现上涨的态势，随后进入震荡行情。2025年一季度台湾半导体指数进入下跌的行情，随后进入上行的态势。

图表9：台湾半导体行业指数近两年走势



图表10：台湾半导体行业指数近两周走势



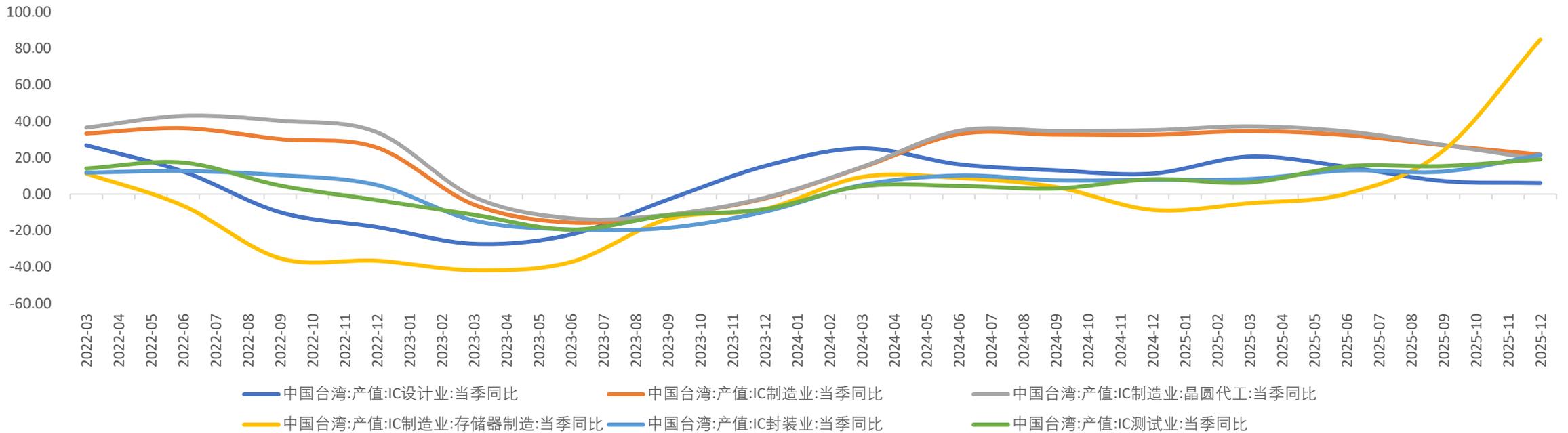
资料来源：wind，华鑫证券研究

## 2.3、半导体：中国台湾IC产值同比增速

我们可以通过中国台湾IC产值同比增速，将电子各板块合在一起观察：

中国台湾IC各板块产值同比增速自2021年以来持续下降，从2023年Q2开始陆续有所反弹，各板块产值降幅均有所收窄。IC板块整体表现不佳，主要因为消费电子需求差，导致IC设计下滑，加之2021年缺货、涨价导致的2022年库存水位上升。但随着AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动，2024年需求开始逐步回升。2025年，中国台湾IC设计、IC制造以及晶圆代工产值同比增速小幅下滑；中国台湾IC封装、测试业产值同比增速为维持平稳的增速；中国台湾存储器制造业进入下半年来，产值同比大幅提升。

图表11：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）



资料来源：wind，华鑫证券研究

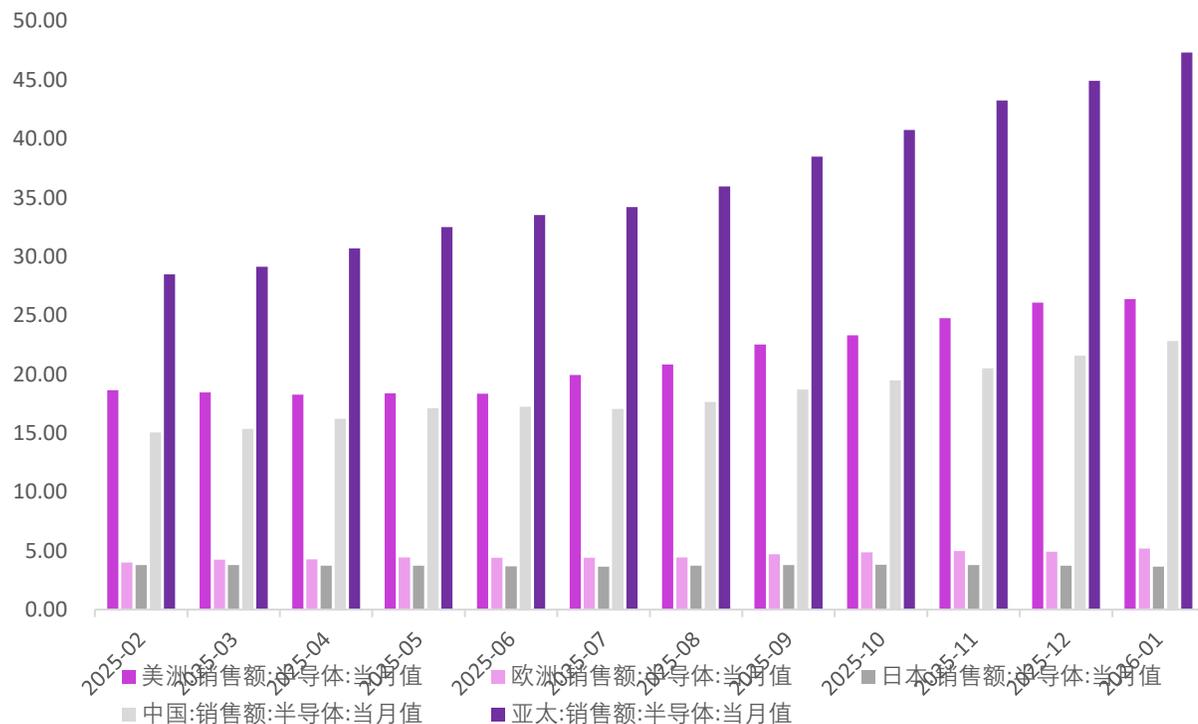
## 2.4、半导体：全球半导体销售额

全球半导体销售额自2024年年底出现小幅下降。2025年4月以来，全球半导体销售额呈现逐月攀升的态势，半导体行业景气度提升显著，2025年6月增速开始放缓，7-10月增速开始回升。2026年1月，全球半导体当月销售额为825.4亿美元，同比增长46.1%。其中，中国销售额为228.2亿美元，环比增长5.75%，占比达27.65%。

图表12：全球半导体销售额（单位：十亿美元）



图表13：全球半导体销售额按地区划分（单位：十亿美元）



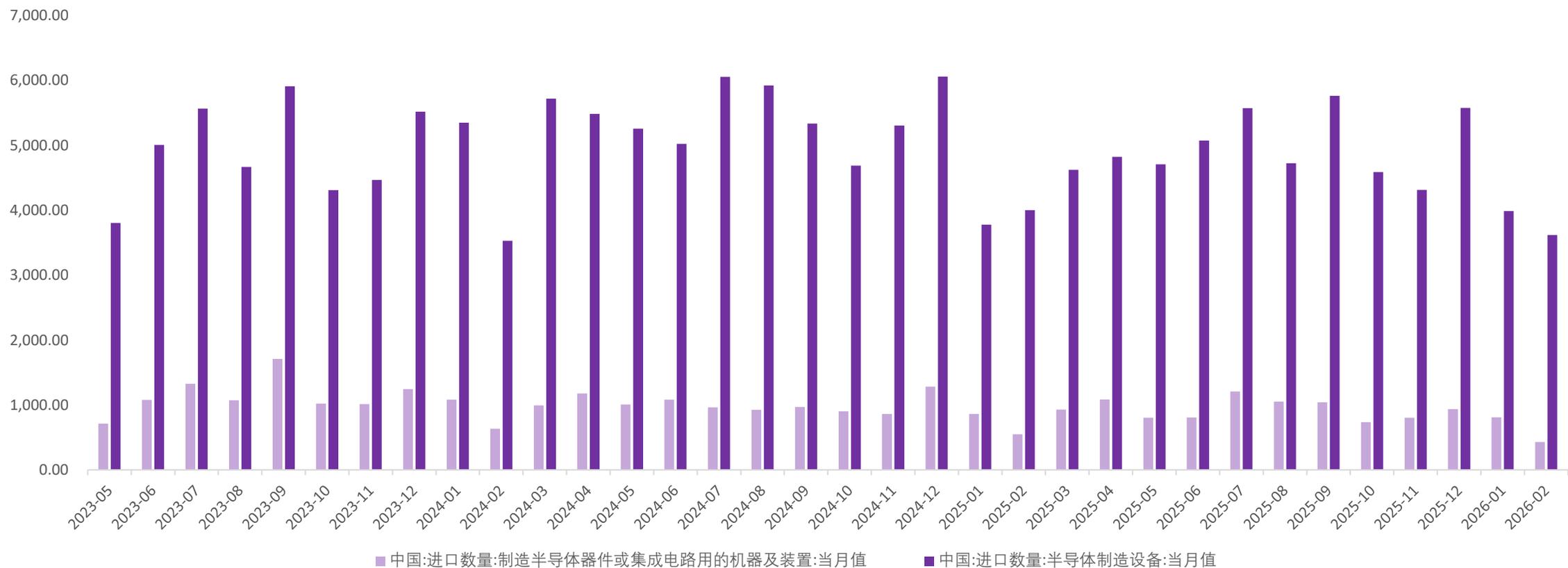
资料来源：wind，华鑫证券研究



## 2.6、半导体：中国进口半导体设备数量

从中国进口半导体设备数量的维度来看，2023年以来，中国的半导体设备进口数量整体呈现平稳的态势。结合上文中国大陆半导体设备销售额攀升的趋势，我们认为国产设备正在逐步提升市场份额。

图表15：中国半导体设备及制造半导体器件或集成电路用装置进口数量（台）

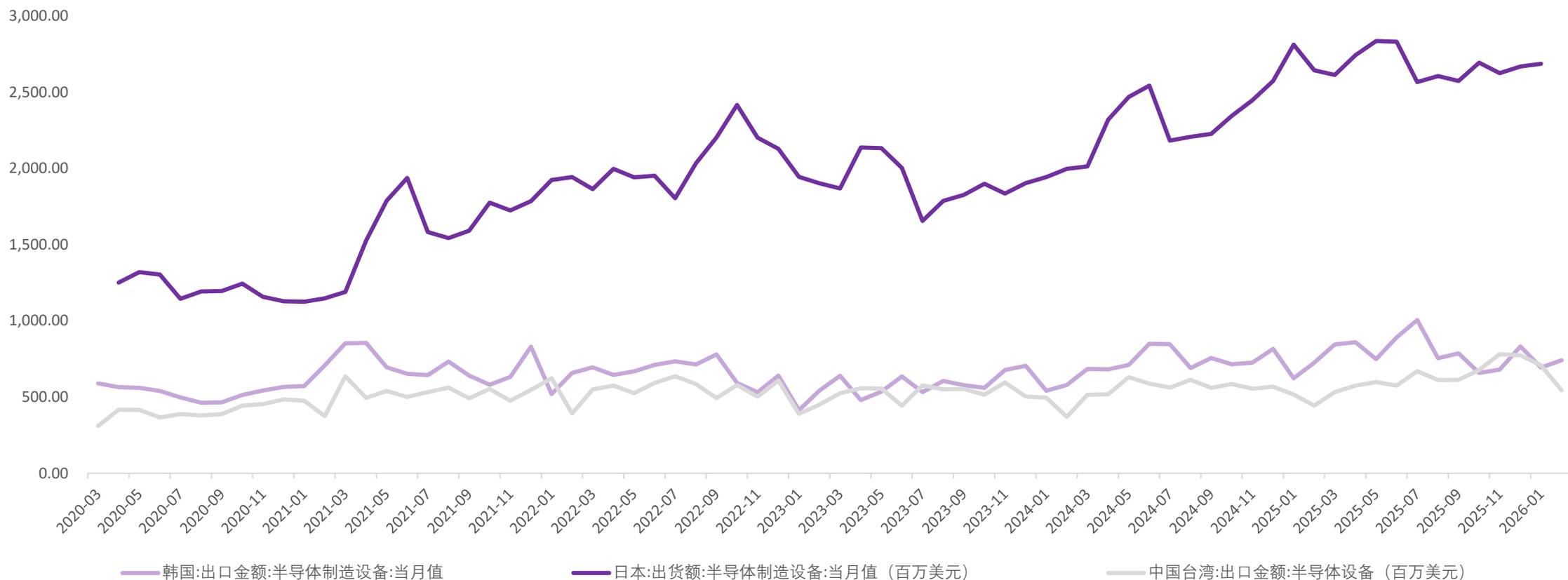


资料来源：wind，华鑫证券研究

## 2.7、半导体：海外市场半导体设备出口额

从海外市场半导体设备出口额的维度来看，2019年以来，韩国和中国台湾的半导体设备出口金额整体维持平稳的态势，日本半导体设备出口额整体呈现上升趋势。

图表16：海外市场半导体设备出口金额（百万美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

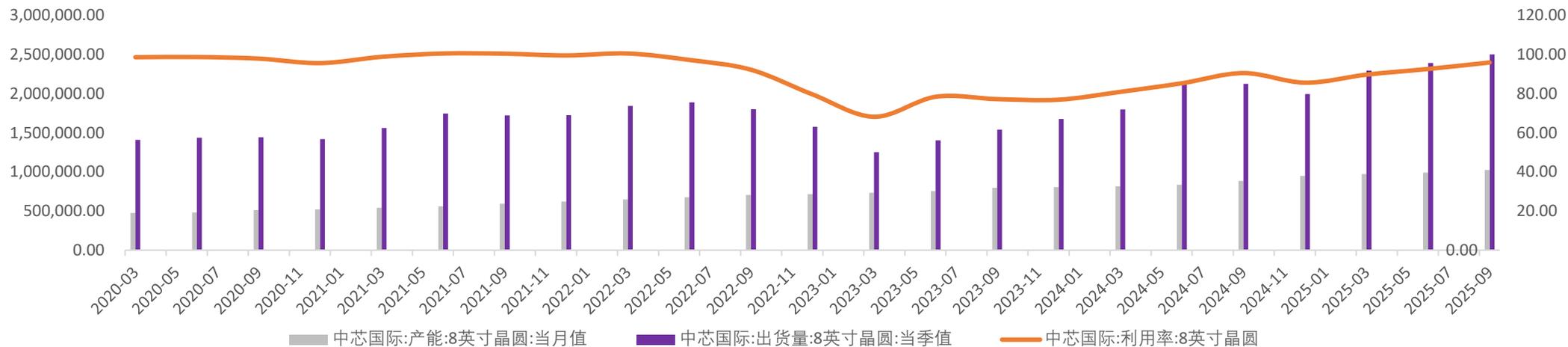
## 2.8、半导体：晶圆制造

晶圆制造方面，2018年至2025年9月，国产晶圆代工厂商中芯国际8英寸晶圆月产能从约45万片稳步提升至约102.3万片，实现翻倍以上增长，并历经稳步爬升、加速扩张及快速扩产三个阶段，尤其在行业调整期间中芯仍坚持逆周期布局，为后续复苏储备了充足产能。

产能利用率清晰地映射行业周期，从2020-2022年高景气期多次超过100%，到2023年下行期下滑至68.1%，随后自2023年第三季度起强劲反弹，至2025年第三季度已恢复至95.8%的高位，接近满产状态。在产能大幅扩张与利用率快速回升的共同推动下，季度出货量规模显著跃升，2025年第三季度达到近250万片，创历史新高，即便利用率未及上轮峰值，实际产出总量已远超以往。

整体来看，国产晶圆代工厂通过逆周期扩产把握了复苏机遇，出货规模的突破体现规模效应增强，也印证了汽车电子、工业控制、物联网等领域对成熟制程芯片需求的持续性与增长潜力。

图表17：国产晶圆代工厂产能、出货量、产能利用率数据（单位：片）

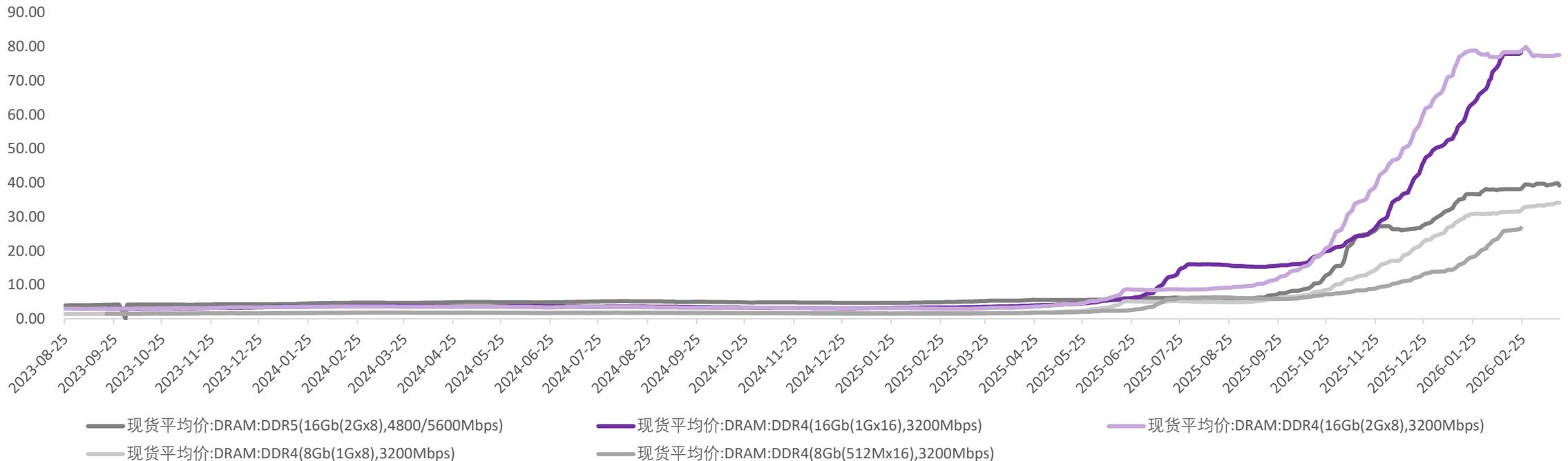


资料来源：wind，华鑫证券研究

## 2.9、半导体：存储芯片

存储芯片方面，由于AI存力需求提升以及海外大厂产能切换HBM等缘故，导致传统DRAM以及NAND类存储芯片价格大幅攀升。NAND方面：Wafer:512GbTLC现货均价从2024年3月底进入小幅回升，10月出现小幅下跌后变化趋于平缓，2025年3月以来小幅上涨，4月后价格略有下滑，7月后价格进入加速上涨阶段。2026年3月9日价格为23.13美元。DRAM方面：DRAM:DDR5(16Gb(8Gx2),4800Mbps)现货均价从2024年3月以来价格小幅上涨，9月之后呈现小幅下跌态势，9月之后又重回下跌态势，2025年1月以来呈现大幅上涨的态势，12月初出现小幅下跌，之后开始进入加速上涨阶段。2026年3月20日价格为39.17美元。

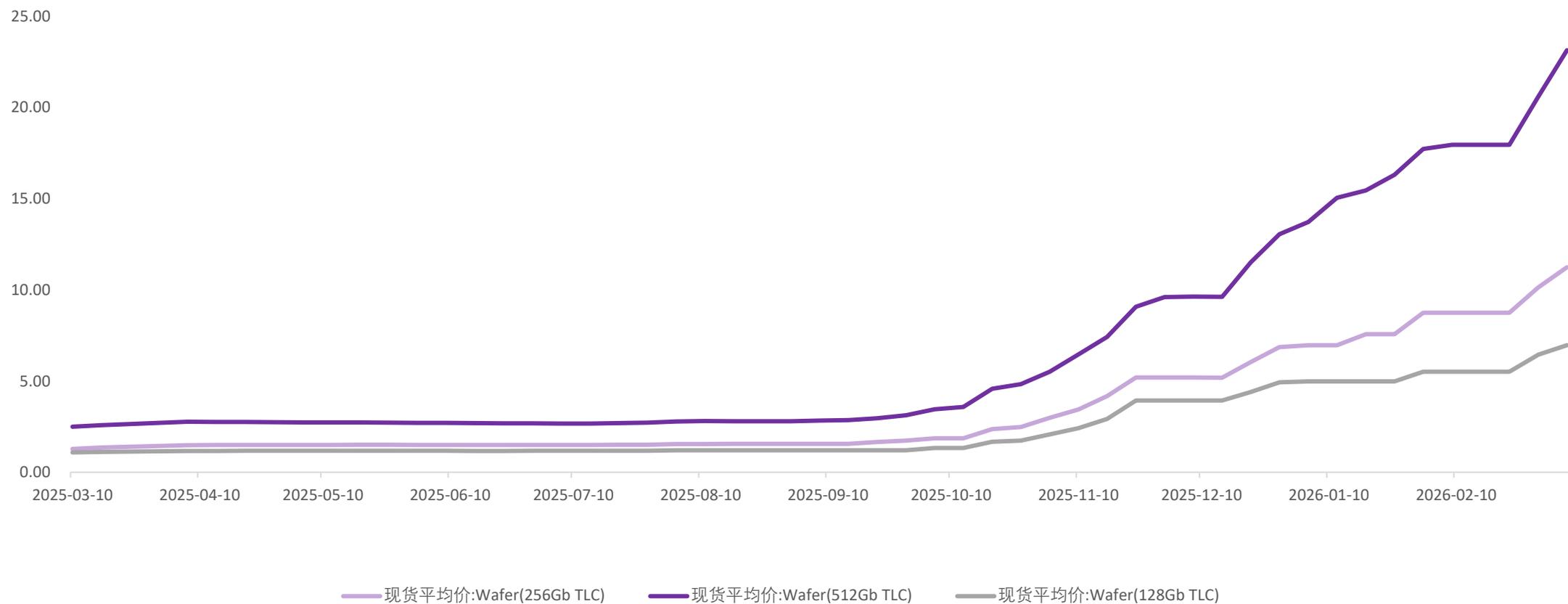
图表18：DRAM价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

## 2.9、半导体：存储芯片

图表19：NAND价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

# 03 行业动态

研究创造价值

### ■ 内存芯片涨价冲击中国智能手机市场，三星电子或受益

尽管市场预期芯片通胀（半导体价格上涨）将导致智能手机需求疲软，但有观察表明，三星电子或许反而能借此机会扩大市场份额。由于人们越来越担心主要专注于中低端产品的中国智能手机制造商在价格上涨阶段可能遭受更大的损失。分析显示，三星电子一直在提高其高端产品占比，因此可能占据相对优势。据多家市场研究公司3月16日发布的报告显示，预计2026年全球智能手机出货量将同比大幅下降。IDC预测，今年全球智能手机出货量将同比下降12.9%，仅为11亿~11.2亿部；Omdia也预测，今年全球智能手机出货量将同比下降约7%。

这一预测表明，随着智能手机制造商（OEM）将内存价格上涨带来的成本负担转嫁给消费者，市场需求将急剧萎缩。受人工智能（AI）服务器扩张带来的强劲需求推动，内存价格大幅上涨。尤其值得注意的是，随着内存厂商加大高利润AI服务器产品的生产，智能手机及其他设备通用内存的供应能力相对下降。

市场观察人士认为，如果智能手机价格上涨的趋势持续下去，拥有高端产品竞争力的企业可能会获得相对更佳的市场地位。这是因为旗舰产品可以根据品牌竞争力将成本上涨反映在售价中，而中低端产品则面临更大的价格上涨导致需求萎缩的风险。分析表明，高度依赖新兴市场中低端产品的中国企业可能会受到价格上涨导致的需求萎缩的更不利影响。事实上，在智能手机价格上涨的背景下，高端厂商的出货量呈现相对增长的趋势。据IDC数据显示，2025年第四季度全球智能手机平均售价（ASP）同比增长约7.7%。同期，三星电子和苹果的出货量分别同比增长约18%和4.9%。相比之下，小米和传音的出货量分别下降11.4%和0.4%。

### 和顺石油收购奎芯科技，拟跨界半导体赛道

3月18日晚间，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“和顺石油”，603353）发布一则重磅公告，宣布其全资子公司和芯微（上海）电子有限公司（以下简称“和芯微”）将以5.4亿元现金，通过股权收购及增资相结合的方式，切入半导体领域，最终实现对上海奎芯集成电路设计有限公司（以下简称“奎芯科技”）的控股。

根据公告细节，和芯微此次5.4亿元的现金投入，将用于收购奎芯科技35.11%的股权，同时受托行使另外16%的股权表决权，两项合计将让和顺石油间接控制奎芯科技51.11%的表决权，顺利将其纳入合并报表范围，成为自身控股子公司。

值得注意的是，此次交易的评估增值率高达821.07%。

#### 俄罗斯16核/32核CPU规格公布 中国龙芯授权

近日，俄罗斯微电子企业Tramplin Electronics（跳板电子）宣布，已获得基于中国LoongArch指令集架构研发的Irtysh（额尔齐斯河）系列处理器首批样品。这款专为自主数据中心、高性能计算场景打造的CPU，成为俄罗斯突破Intel、AMD x86架构制裁封锁的核心方案。

此次公布的首批样品包含16核Irtysh C616、32核Irtysh C632两款型号，产品目录中还同步规划了64核的C664版本。全系列均基于LoongArch LA664内核，采用六发射、乱序执行流水线微架构，支持多线程技术，支持128位LSX、256位LASX矢量扩展指令。具体参数上，16核型号主频2.2GHz，配备32MB三级缓存，支持四通道DDR4-3200内存，峰值浮点性能844.8 GFLOPS，TDP为100-120W；32核型号主频2.1GHz，配备64MB三级缓存，支持八通道DDR4-3200内存，峰值浮点性能1612.8 GFLOPS，TDP为180-200W。

官方称，该系列处理器性能可对标Intel上一代至强处理器，与AMD Zen3、Intel Ice Lake系列产品具备同级竞争力。

2025年10月，跳板电子就完成了龙芯架构技术的引进工作，签订正式授权协议后，不仅获得了LA664内核、DDR4内存、PCIe 4.0物理层等核心技术授权，还拿到了龙架构的自主开发修改权限

### 美光与三星恢复存储芯片长期合约谈判

3月19日消息，在存储芯片供应极其紧缺的背景下，自去年四季度以来，三星、SK海力士、美光这三大存储芯片原厂为了利益最大化，纷纷停止了与客户签署长期合约，转而以季度合约甚至更短的月度合约代替，以及时反映市场价格。但是，随着存储芯片价格达到目前的高位，后续继续大涨的可能性正在降低，反而价格下跌的风险正在积累，美光和三星为了降低风险，开始恢复与客户进行长期合约的签署和谈判。

在美光的2026财年第二季财报会议上，美光总裁兼执行长Sanjay Mehrotra表示，美光已与客户签署首个五年期的长期合作协议（SCA），其中包含了详细的多年期承诺。

另据外媒报道，近日三星电子副董事长兼CEO全永铉在接受媒体采访时表示，三星正在与主要客户合作，将交易模式转变为固定期限的供应合同，即三年至五年期限的长期协议。这么做预计能够尽早察觉市场的波动，提前确认这些信息就能更灵活地调整投资规模。对于那些签下长期合约的客户，三星还会给予小幅度折扣。

### 平头哥自研GPU已累计交付47万片

3月19日，在2026财年Q3财报分析师电话会上，阿里巴巴表示，平头哥自研的GPU芯片（真武810E）已实现规模化量产，截至2026年，已经累计规模化交付47万片。

在阿里云的实际业务场景，60%以上的平头哥AI芯片服务于外部商业化客户，已完成规模化外部客户AI任务适配，支持了400多家企业客户的AI任务，涵盖包括互联网、金融服务、自动驾驶等多个行业。

资料显示，真武810E GPU是平头哥旗下首款云端AI芯片，采用自研并行计算构架和片间互联技术，配合全栈自研软件栈，实现了软硬体全自研。其内存为96GB HBM2e，片间互联带宽达到700 GB/s，可应用于AI训练、AI推理和自动驾驶。阿里巴巴已将真武810E大规模用于千问大模型的训练和推理，并结合阿里云完整的AI软件栈进行深度优化，为客户提供一体化产品和服务。

据业内人士透露，对比关键参数，真武810E整体性能超过了英伟达A800和主流国产GPU，与英伟达H20相当。另据外媒报道，升级版“真武”的性能强于英伟达A100。多位行业从业者表示，真武性能优异稳定、性价比突出，在业内口碑良好，市场供不应求。

值得一提的是，因全球AI需求爆发、供应链涨价，行业核心硬件采购成本显著上涨，3月18日，阿里云宣布将于2026年4月18日起对平头哥真武810E等算力卡相关服务产品价格上涨5%-34%。

### 营收大涨57.7%，2025年地平线征程系列芯片出货量超400万套

3月19日，港股智驾科技核心标的地平线机器人-W（9660.HK，简称“地平线”）发布2025年业绩公告。地平线2025年全年营收达人民币37.58亿元，同比增长57.7%；毛利润达24.3亿元，毛利率维持64.5%高位，其中汽车业务毛利率达67.2%。年内亏损为104.69亿元，而2024年则录得年内利润23.47亿元。2025年研发开支为51.54亿元，同比增长63.3%。2025年，地平线征程系列芯片出货量超400万套，同比增长38.8%，规模化交付能力领跑行业。其中，中高阶芯片出货量达180万套，较2024年同期增长近5倍，出货量占比提升至48%，并贡献了超80%的产品与解决方案业务收入。地平线两大主营业务收入均实现高速增长。产品解决方案业务营收大幅跃升至16.22亿元，同比增长144.2%，占比从2024年28%提升至43%；授权及服务业务营收实现19.35亿元，增长达17.4%。公告还显示，地平线在2025年中国20万元以下主流车型市场中，中高阶智驾方案市场份额达44.2%，稳居第一。2025年11月量产的全场景城区辅助驾驶方案HSD，上市一月交付超22,000套。

### 英特尔CPU全面涨价10%

3月20日消息，据韩国媒体ETnews报道，处理器大厂英特尔已经通知主要客户，计划从3月底开始将面向PC产品的大部分CPU价格调涨10%。此前，市场研究机构TrendForce也曾发布报告称，英特尔已调整部分入门级、前代笔记本电脑CPU报价，幅度超过15%，2026年第二季还将提高主流至中高端CPU平台价格。

值得一提的是，此前就有消息显示，由于超大规模云服务商的扫货，英特尔和AMD在2026全年的服务器CPU产能已接近售罄，而为了应对供需极端失衡并确保后续供应稳定，两家公司均计划将服务器CPU价格上调10%-15%。

业内人士表示，由于人工智能（AI）数据中心对于包括服务器CPU、HBM及企业级SSD等各类半导体需求激增，导致了相关厂商将产能更多地分配给了利润率更高的数据中心产品，对于消费类的CPU、DRAM和NAND的供应减少，供不应求的市场状况推动了涨价。此外，上游原材料、制造成本的持续上涨，也是导致了众多芯片厂商自去年底以来开始陆续涨价。

### 台积电产能紧缺，三星将在美国建第二座2nm晶圆厂

3月18日消息，根据韩国《中央日报》的报导，由于晶圆代工大厂台积电的产能已经面临极度紧绷的状态，促使美国各大科技厂商纷纷开始排队寻求其他晶圆代工产能的支持。在此强烈需求的背景下，韩国三星电子正积极筹备，准备在其位于美国德克萨斯州泰勒市的庞大半导体园区内，新建第二座晶圆厂（Fab 2）。报道指出，根据泰勒市议会最新披露的官方文件显示，三星电子在该园区的第二座晶圆厂建设计划已经正式进入监管审查与准备的初步阶段。数日之前，泰勒市议会已经无异议全票通过了一项修正案，该修正案的核心在于延长泰勒市与美国HDR工程公司（HDR Engineering, Inc.）的合作合约，使市政府能够持续为三星电子规划中的第二座晶圆厂提供必要的开发许可审查与支持。

根据合约内容，HDR工程公司将肩负多项关键重任，包含执行晶圆厂的设计图审查、协助三星电子取得必要的建筑许可证、处理许可证的核发流程，以及执行严格的建筑规范与合规性检查。这些检查主要在确保施工期间的安全性，并确认整个建设项目均严格遵循已获批准的计划标准。报道指出，一旦相关的建筑许可证正式核发到位，Fab 2的主体建设工程便会立即启动。从规模来看，这座规划中的Fab 2厂房预估占地面积将高达约270万平方英尺，其量体规模与目前正在施工中的第一座厂房（Fab 1）完全相同。然而，三星电子的长远目光并不仅局限于这两座厂房。为了支撑未来的长期发展，三星电子在泰勒市总共收购了广达1,268英亩的土地，用于打造其专属的半导体产业聚落。这片广袤的腹地极为庞大，最高甚至可以容纳多达10座先进晶圆厂，为未来的产能扩张预留了极具弹性的发展空间。

# 04 公 司 公 告

研究创造价值

### 神工股份:关于2025年度计提资产减值准备的公告

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经公司财务部门测算，公司2025年计提的各项减值损失总额为1,723.37万元。

### 锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年3月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。董事会审议同意《锦州神工半导体股份有限公司2025年度董事会工作报告》的内容，并分别听取了《锦州神工半导体股份有限公司2025年度独立董事述职

### 神工股份:董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事冯培、张仁寿、王永成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事冯培、张仁寿、王永成的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海市证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

### 普冉股份:关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用部分超募资金人民币1.86亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额90,009.34万元的比例为20.66%（含利息及现金管理收益等，最终补流转入公司自有资金账户的实际超募资金金额以资金转出当日超募资金专户余额为准）。

公司承诺：每12个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求；在本次永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本事项经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东会审议。

# 05 风 险 提 示

研究创造价值

半导体出口管制及制裁加码风险

晶圆厂扩产进度不及预期风险

核心技术研发进展不及预期风险

地缘政治环境不稳定风险

重点覆盖公司业绩不及预期风险

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信、存储等领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

## 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 免责条款

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

## 证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	>20%
2	增持	10%—20%
3	中性	-10%—10%
4	卖出	<-10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	>10%
2	中性	-10%—10%
3	回避	<-10%

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

**相关证券市场代表性指数说明：**A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。



华鑫证券

CHINA FORTUNE SECURITIES

研 究 创 造 价 值